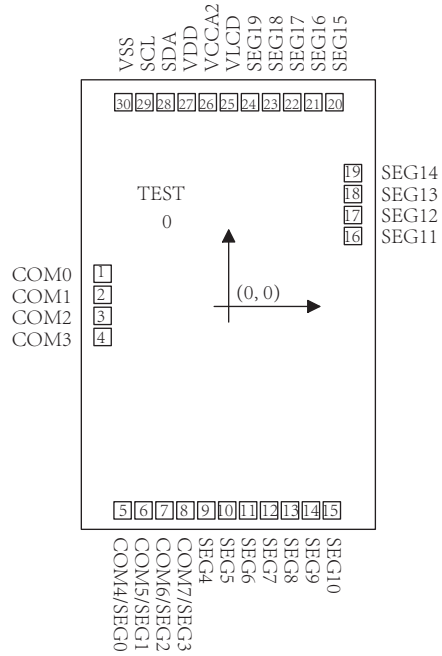


## VK2C21 COB资料

### COB PAD图



芯片面积:  $1150 \times 1715 \text{ um}^2$  , 衬底电位: VSS

PAD 大小:  $70 \times 70 \text{ um}$

VDD (Pad27) 和 VCCA2 (Pad26) 必需绑定在一起。

VLCD (Pad25) 和 SEG19 (Pad24) 必需绑定在一起。

VLCD脚配置为检测内部偏置电压时, LCD 驱动电压可通过 VLCD 引脚提供的电压进行外部温度补偿。

## COB PAD坐标

单位：μm

序号	名称	X坐标	Y坐标	序号	名称	X坐标	Y坐标
1	COM0	93.11	1016.655	17	SEG12	1056.89	1621.89
2	COM1	93.11	932.155	18	SEG13	1056.89	1265.89
3	COM2	93.11	847.655	19	SEG14	1056.89	1350.39
4	COM3	93.11	763.155	20	SEG15	1040.39	1621.89
5	COM4/SEG0	130.97	93.11	21	SEG16	950.39	1621.89
6	COM5/SEG1	220.97	93.11	22	SEG17	860.39	1621.89
7	COM6/SEG2	310.9	93.11	23	SEG18	756.75	1621.89
8	COM7/SEG3	400.97	93.11	24	SEG19	666.75	1621.89
9	SEG4	490.97	93.11	25	VLCD	576.75	1621.89
10	SEG5	580.97	93.11	26	VCCA2	486.75	1621.89
11	SEG6	670.97	93.11	27	VDD	396.75	1621.89
12	SEG7	760.97	93.11	28	SDA	306.75	1621.89
13	SEG8	850.97	93.11	29	SCL	199.61	1621.89
14	SEG9	940.97	93.11	30	VSS	109.61	1621.89
15	SEG10	1030.97	93.11				
16	SEG11	1056.89	1096.89	0	TEST	295.57	1211.795